

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

合肥芯基微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 6 月 27 日发布《合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动方案报告如下：

一、深耕主业，筑牢高端制造技术护城河

2024 年全球经济复苏叠加 AI 算力爆发、数据中心扩容及汽车智能化浪潮，半导体与 PCB 行业需求激增，国产替代进程加速。公司依托微纳直写光刻技术积淀，加速产品迭代创新，推出适配芯片制造、先进封装及新能源汽车等场景的高性能设备，深化境内外市场布局；同时加强产业链协同，优化供应链体系，构建“技术领先+快速响应”的全球竞争力，致力于成为微纳直写光刻领域国际领军企业，为全球高端制造注入创新动能。报告期内公司保持稳健增长态势，在技术创新、市场拓展、产业协同等维度实现突破性进展，核心竞争力持续强化。

1、PCB 战略深化：高端化+国际化+大客户战略持续发力

2024 年公司持续推进主业高端化升级，通过技术攻坚实现 HDI

板、类载板、IC 载板等高端 PCB 设备市场突破，依托具备 3-4 μm 线宽制程能力的 MAS 系列设备巩固国内领先地位。受益于 AI 服务器、智能驾驶等新兴领域需求爆发，高阶产品订单表现良好，市场份额持续扩大。在国际化战略层面，公司加速全球布局，通过设立泰国子公司深度参与东南亚 PCB 产业转移，推动东南亚地区营收占比大幅提升，并与鹏鼎控股、日本 VTEC 等国际客户深化战略合作，实现了高端设备在海外市场的批量交付。报告期内，公司进一步强化大客户战略，在巩固与鹏鼎控股、胜宏科技等行业龙头合作的基础上，成功进入京东方供应链体系，形成标杆客户示范效应，为后续规模化扩张与全球化竞争奠定坚实基础。未来公司将持续以技术创新为驱动，依托行业领先的直写光刻技术优势，加速拓展全球高端市场份额。

2025 年公司将持续推进 PCB 领域智能化升级与高端化延伸战略，在产品端聚焦激光加工技术深化应用，通过优化 UV 激光钻、CO₂ 激光钻的参数与工艺，提升高多层板、HDI 板等高端产品钻孔精度与效率，进一步巩固激光钻孔细分市场竞争力；针对 FPC 轻薄可弯曲特性开发 RTR-NEX 设备，通过结构与控制系统优化提升曝光精度，精准适配消费电子、汽车电子等领域对柔性电路板的应用需求。技术开发端同步突破，构建 PCB 整机系统对位模型并引入算法优化，实现多层板对位精度显著提升；研发全自动标定方案有效解决设备调试效率瓶颈；通过平台子系统可靠性测试与专项性能分析，强化设备长时间稳定运行能力，为高端化智能化发展筑牢技术底座。

2、泛半导体多领域协同突破，国产替代加速共振

2024 年公司持续深化半导体及高端制造领域战略布局，在 IC 载板领域通过 3-4 μm 高解析度技术突破实现国产替代加速，MAS4 设备客户端验证进展顺利，新一代 MAS 6P 与 NEX 30 解决方案成功应用于高阶 HDI 及 IC 载板量产，定增项目同步推进产能扩张与海外市场开拓；先进封装领域围绕 AI 芯片需求构建全链条技术优势，WLP 晶圆级封装设备通过数字掩模技术优化再布线工艺，PLP 板级封装设备实现产能效率与成品率双重突破；掩膜版制版业务加速布局 90nm-65nm 节点设备研发，构建从设备到工艺的全链条技术壁垒；引线框架领域以蚀刻工艺替代传统冲压，超薄产品成功导入核心客户供应链；功率半导体领域推出 MLF 系列数字光刻设备，首次出口日本标志全球化战略突破；新型显示领域针对 Mini/Micro-LED 技术开发 NEX-W 机型，成功切入京东方等头部客户供应链，屏幕传感器 RTR 及 LCD 制程设备获国际订单，进一步巩固了高端显示设备市场地位。

2025 年公司在泛半导体领域持续深化技术布局与产品创新，产品端聚焦晶圆级封装、MLC 系列、LDW 领域及 IC 载板等核心赛道，开发 WLP1000 高端封装设备优化大尺寸晶圆曝光工艺，提升产能效率巩固市场地位；推出模块化设计的 MLC Lite 设备提供高性价比光刻解决方案；通过光学系统与算法优化升级 LDW 350 设备解析度与速度，满足芯片制造及掩模版制版需求；针对 IC 载板设备，升级光学与运动控制技术抢占中高端市场份额。在泛半导体前沿赛道，公司将深度融合高精度控制与材料科学技术探索键合工艺创新，同时通过光学检测与智能算法实现薄膜量测参数精准感知。技术开发端同步突破光源

标准化研究提升稳定性以适配更高解析度需求，并构建软件公共平台整合控制与数据管理功能，强化设备智能化水平与技术壁垒。

3、 产品矩阵持续深化，平台化战略赋能产业升级

在 PCB 中高阶市场，公司通过技术创新与产能扩张双轮驱动战略，推出覆盖多层板、HDI 板、柔性板及 IC 载板的系列设备，以高精度曝光、高良率、高效生产及成本优势加速国产替代。报告期内，公司重点提升高端阻焊市场 NEX 系列设备产能，同步发布钻孔新品 MCD75T，集成实时校准检测、能量监控及 LDI 算法技术，显著提高微孔与线路位置精度，进一步巩固在中高端 PCB 设备领域的竞争力。

2024 年 4 月公司成功推出 WA8 晶圆对准机与 WB8 晶圆键合机两款半导体关键设备，精准适配先进封装、MEMS 生产等亚微米级对准场景，彰显技术创新实力与行业先发优势。公司在先进封装领域形成“直写光刻+对准+键合设备”矩阵，并同步布局量测、曝光、检测技术路线，通过关键设备组合构建平台化技术优势，深度融入国产先进封装设备替代浪潮，打造业务增长新引擎。

二、 加快数智新产业发展，提升经营质量

2024 年公司全面推进数智化战略升级，通过构建覆盖研发、制造、供应链、销售、财务等全业务链的信息化平台体系，实现数据治理与业务流程深度融合：在研发管理领域，加速 IPD 项目落地并完善 PLM 系统，推进产品平台化建设与矩阵式管理，强化知识产权布局，显著提升技术开发效率与成果转化能力；客户管理方面，构建 CRM 系

统实现市场获客、销售服务全流程可视化，优化客户生命周期管理，提升满意度；财务领域上线智能费控系统，构建费用全生命周期管理体系，实现成本控制与风险管控双突破；智能制造板块，推进供应链 SRM 与仓储 WMS 系统建设，搭建一站式采购协同平台，夯实精益制造基础。通过数智化工具与管理变革，实现了运营效率、产品质量与客户价值的系统性提升，为业务规模化发展与全球化竞争筑牢数字化底座。

2025 年，公司将从研发、销售、制造、管理四个关键维度，推进数字化转型与创新升级。研发端，融合 IPD 和 PLM 双系统，搭建全流程标准化管理机制与模块化开发平台，布局核心技术模块，集成 AI 辅助设计，强化知识产权布局；销售端，推进智慧 CRM 二期建设，建立客户管理体系，实施全球化客户生态战略，提升商机转化与客户留存；制造端，加速供应链数字化转型，搭建供应商协同与采购管理平台，推进 SRM 和 WMS 系统建设，优化仓储运营；管理端，深化业财一体化，构建数字化费用管理平台，实现自动化审批与多维度分析，规避税务风险，助力精细化决策。

三、强化价值创造，提升股东回报

公司秉持“价值创造为本、利益共享为纲”的核心发展理念，构建起资本市场回报与战略发展深度协同的双向赋能机制，通过现金分红筑根基、股份回购强信心的组合策略，推动股东利益与公司价值的良性互动和同步提升。

在现金分红层面，公司以持续稳定的分红政策回馈投资者，报告

期内，公司以总股本剔除回购股份后的 130,941,764 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利达 104,753,411.20 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 58.42%，这一高比例分红不仅让股东直接共享公司经营成果，更通过制度化的分红安排稳定市场预期。与此同时，公司同步推进管理层与股东利益共担共享机制建设，通过长效激励制度设计与治理结构优化，将管理层绩效与股东回报深度绑定，激发核心团队创造力，为公司长远发展注入内生动力。

在股份回购层面，基于对公司技术优势、市场前景及长期价值的坚定信心，实际控制人、董事长程卓女士于 2024 年 2 月提议启动股份回购计划，旨在通过资本市场工具维护投资者利益、提振市场信心。截至 2024 年 7 月，公司此次回购计划实施完成，通过集中竞价交易方式累计回购股份 477,322 股，占总股本的 0.3632%，支付资金总额达 30,016,900.65 元（不含交易费用）。此次回购不仅彰显了管理层对公司内在价值的深度认可，更通过真金白银的投入构建起上市公司与投资者的利益共同体，为公司股价稳定性与市场认同度提供有力支撑。

2025 年，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

报告期内，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体如下：

1、加快落实独立董事制度改革

公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则等公司治理制度，深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

2、完善内控建设

为了更好的落实公司内部审计工作的开展，促进内部控制的建设推进，有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，参照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》和《审计署关于项目审计工作的规定》，结合公司实际情况，特制定了《内部审计实施细则》，建立健全了内部审计制度，有助提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计监管力度，确保公司合规经营。

3、加强董监高相关培训

公司董事、监事、高级管理人员积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作，公司未来亦将全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与相关培训。公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，从上至下强化合规建

设，重视合规管理和内部监督，持续促进公司规范运作，切实推动公司高质量可持续发展。

2025 年，公司将持续完善公司治理体系及制度建设，一是全面贯彻新《公司法》及证监会、交易所最新规则要求，修订《公司章程》及配套治理制度，规范股东会及董事会运作机制，优化董事会下设审计委员会职能，强化中小股东权益保护，切实维护投资者合法权益。二是深化内部控制体系建设，完善涵盖风险识别、评估、应对及监控的全流程闭环管理，强化关键业务环节合规审查，确保经营活动合法性与经营效率双提升。三是运用好资本市场法律规则动态跟踪机制，针对注册制改革、信息披露新规等政策变化，及时修订内部制度并开展专项培训，保障公司运作与监管要求同步。

五、加强募投项目管理，提升科技创新能力

报告期内，在募投项目的实施过程中，公司持续严格遵守相关法规指引及《公司募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，加速推进募投项目建设，以募投项目的落地巩固并提升公司行业竞争地位，拓宽公司业务覆盖度的深度及广度，敏锐把握市场发展机遇，实现公司主营业务的可持续发展。

2025 年，公司将继续加快推进募投项目建设，争取早日达成并实现预期效益，以增强公司盈利水平。同时，公司将在目前业务稳步增长的同时，合理利用募集资金拓展业务创新机会，持续关注行业发展趋势，为客户提供更优质的产品，发掘新的利润增长点，在激烈的市场竞争中赢得先机。

六、提高信息披露有效性，常态化投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平，增强市场透明度，树立良好企业形象。2024 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司发布定期报告后，采取了业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高了信息的直观性和可理解性。

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证 E 互动”平台的问题，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司的质量提升。在投资者关系管理方面，公司积极组织投资者调研活动，与投资者面对面交流，在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任与支持。

2025 年，公司将继续采用多种有效的投资者关系活动方式，充

分利用投资者 专线、投资者关系邮箱、官网投资者专栏以及“上证 E 互动”等沟通渠道，回复 投资者关切的各种问题。同时，公司将在披露定期报告后常态化召开业绩说明会，并邀请公司董事、管理层等参与沟通交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况及发展理念。此外，公司将积极组织及参与各类线上线下调研、路演、券商策略会等活动，积极与投资者沟通互动，展现公司良好形象。

七、压实“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

报告期内，公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和中小投资者利益的情况，在业务、人员、资产等方面与公司保持独立。公司通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督。公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

2025 年公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司 高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与 考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公 司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合。进一步强化 管理层与股东

的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识责任担当，推动公司的长期稳定发展。

八、其它事宜

公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进公司的平稳健康发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日